

高精度ダイボンダー

ALPHA
DESIGN

HSDB-200

ALPHA SOLUTION LINE-UP



ダイシング済みのチップを、
高精度かつ高速に実装する装置です
イメージセンサー等の長尺チップの実装に最適です

■ 特長



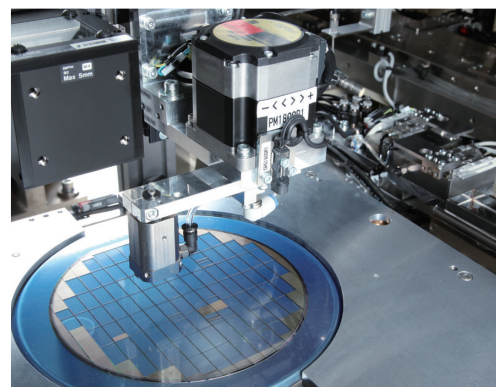
HSDB-200

1. チップを高精度高速搭載
2. 搭載精度 $\pm 5\mu\text{m}$ 以下を実現
3. ヘッド自重キャンセル機構による、一定微荷重位置制御
4. 基板の高さを検知し、Z軸の下降量を自動補正
5. 実装精度の自動測定機能(オプションにより対応)
6. チップの貼り付け方向を選ばない360度ピックアップにより、様々な実装方法に対応可能

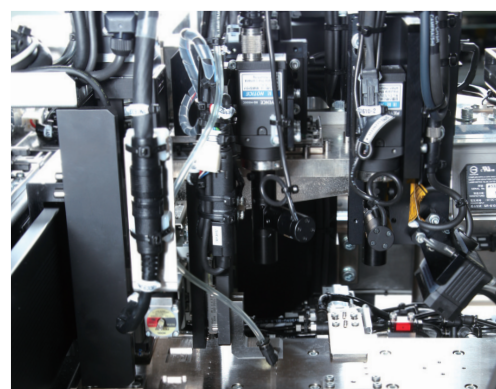
■ 標準仕様

機種名	高精度ダイボンダー	
型式	HSDB-200	
対象基板材質／サイズ	ガラスエポキシ／10×250mm～90×420mm 厚さ:0.5～2.5mm	
対象部品	0.15×8×0.1t～0.3×24×0.3t mm	
実装可能範囲	基板サイズと同一 *1	
実装済み部品高さ	基板上面 最大3mm	
装置サイズ	幅(W) 1,820×奥行(D) 1,610×高さ(H) 1,600mm(*3色灯除く)	
重量	約2,800kg	
設置条件	床面状態±10mm	
動力源	電源	3相 AC200V±5% 40A(50/60Hz)
	ドライエア	0.4MPa(±10%) 500L/min(A.N.R)
	真空部	－80kPa(±10%)または装置内で真空源を確保
部品供給形態	8インチ、6インチウエハ *2	
基板供給 形態	マガジン供給	最大ストローク範囲250mm以内
	ストック数	ローダー側1個 アンローダー側1個
機械実装精度	XY:±5μm θ:±0.05°	
実装サイクル時間	目標値 2.8sec./1部品*3	
ヘッド加圧力	デジタル制御	
実装方向	基板長手方向に対し、チップ長手方向で搭載 オフセット実装・対称実装可能	
環境条件	温度:20～25℃ 湿度:50～70%RH 付近にノイズ源のなきこと	
操作方法	7インチタッチパネル	
警告灯	パトライト社製 LE-302FBP-RYG (RoHS指令適合品)	
オプション	実装確認(実装後、画像処理にて基本精度を確認)	

*1 基板外形規正時は実装範囲は減少 *2 ダイシング済み、フレーム貼り付け済みのものに対応します *3 接合に要する時間を除く



ピックアップ部・突き上げ部



チップ認識カメラと搭載ステージ部
高精度実装を実現するヘッド構造

お問い合わせは

アルファデザイン株式会社

〒389-0511 長野県東御市滋野甲2211-3
TEL 0268-64-0088 FAX 0268-64-0080
<http://www.alpha-design.co.jp/> seihin@alpha-design.co.jp

埼玉支社

〒350-1123 埼玉県川越市協田本町7-6 ダイゴビル5F
TEL 049-293-2795 FAX 049-293-2796

福岡支社

〒819-1122 福岡県糸島市東1963-4 社会システム実証センター 研究開発ラボ205号室
TEL 092-331-8001 FAX 092-331-8041

●記載の製品の仕様・外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。
●このカタログの記載内容は2013年4月現在のものです。